



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO								
DEPARTAMENTO:	Electrónic	Electrónica						
ACADEMIA A LA QUE PERTENECE:	Electrónica Analógica Aplicada							
NOMBRE DE LA MATERIA:	Tecnología de Semiconductores							
CLAVE DE LA MATERIA:	ET321							
CARÁCTER DEL CURSO:	Especializ	ante						
TIPO DE CURSO:	Curso							
No. DE CRÉDITOS:	11							
No. DE HORAS TOTALES:	80	Presencial	68	No presencial	12			
ANTECEDENTES:	ET202							
CONSECUENTES:								
CARRERAS EN QUE SE IMPARTE:	Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica							
FECHA DE ULTIMA REVISIÓN:	28 de Ju	lio de 2013						

PROPÓSITO GENERAL

El alumno manejará los conceptos relacionados con la nomenclatura química y la estructura de los cristales semiconductores y las técnicas de crecimiento de los mismos. Además, conocerá los procesos requeridos para la fabricación de dispositivos electrónicos y circuitos integrados incluyendo, oxidación, contaminación, metalización, montaje y encapsulado. El alumno comprenderá las propiedades eléctricas de los semiconductores, tales como bandas de energía, concentración de portadores, generación, recombinación y las propiedades de los contactos rectificante, óhmico, etcétera. Conocerá el comportamiento detallado de la unión PN y de los transistores bipolares.

OBJETIVO TERMINAL

El alumno tendrá la habilidad de analizar, comprender e investigar acerca de los procesos de fabricación y diseño de circuitos integrados a nivel silicio, realizará simulaciones de su comportamiento con programas de cómputo e investigará en artículos contemporáneos la tendencia de los diversos fabricantes.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es una materia interdisciplinaria ya que para su comprensión se requieren





CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

materias tales como: química (la parte de elementos, nomenclatura y algo de balanceo de ecuaciones), ciencia de materiales, mecánica clásica, estadística y quántica, para la comprensión de los fenómenos que acontecen con las partículas subatómicas y atómicas (de los portadores mayoritarios o minoritarios) de los diversos compuestos químicos que intervienen en la fabricación y/o diseño de los semiconductores.

HABILIDADES Y DESTREZAS A DESARROLLAR

El alumno desarrollará la habilidad de analizar, comprender e investigar acerca de los procesos de fabricación y diseño de circuitos integrados a nivel silicio, realizará simulaciones de su comportamiento con programas de cómputo e investigará en artículos contemporáneos la tendencia de los diversos fabricantes.

ACTITUDES Y VALORES A FOMENTAR

La responsabilidad, la disciplina y el compromiso son los valores que se fomentarán durante el desarrollo de esta materia.

	metodología de enseñanza aprendizaje								
	Métod o	Método tradiciona I de exposició n	Método Audiovisua I	Aula Interactiv a	Multimedi a	Desarroll o de proyecto	Dinámica s	Estudi o de casos	Otros (Especificar)
L	%	20	40			20		20	

		CONTENIDO TEMÁTICO				
MODU	MODULO 1.					
El alun nomen cristali	clatura quí	DDULO cerá analizará y comprenderá la tabla periódica, la mica, el balanceo de ecuaciones en general, las estr y las tecnologías que involucran la obtención de mat				
			enales			
1.1	TEMA: NO		12 HRS			
1.1	OBJETIVO					
1.1		MENCLATURA QUÍMICA				
1.1	OBJETIVO	MENCLATURA QUÍMICA				





		la tabla periódica.	
	1.1.2	SUBTEMA:	2
		Reglas a seguir para la escritura de la formula	
		química del compuesto	
		OBJETIVO DEL SUBTEMA El alumno comprenderá	
		las reglas básicas a seguir para la escritura de	
		las formulas químicas de los compuestos	
	1.1.3	SUBTEMA: Óxido	2
		OBJETIVO DEL SUBTEMA El alumno comprenderá	
		las reglas básicas a seguir para la escritura de	
		los óxidos.	
	1.1.4	SUBTEMA: Hidróxidos e Hidruros	2
		OBJETIVO DEL SUBTEMA El alumno comprenderá	
		las reglas básicas a seguir para la escritura de	
		los Hidróxidos e Hidruros.	
	1.1.5	SUBTEMA: Ácidos Hidrácidos	2
		OBJETIVO DEL SUBTEMA El alumno comprenderá	
		las reglas básicas a seguir para la escritura de	
		los Ácidos Hidrácidos.	
	1.1.6	SUBTEMA: Anhídridos y Ácidos Oxácidos	2*
		OBJETIVO DEL SUBTEMA El alumno comprenderá	
		las reglas básicas a seguir para la escritura de	
		los Anhídridos y Ácidos Oxácidos.	
1.2	TEA.A.A. E.G	STRUCTURAS CRISTALINAS	10 HRS
1.2			IU HK
		D DEL TEMA: El alumno analizará y comprenderá la	
		ón espacial de los patrones atómicos, redes de los diferentes elementos y compuestos utilizados	
		icación de semiconductores	•
	1.2.1	SUBTEMA: Geometría del cristal	
	1,2,1	OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno analizará	-
		comprenderá la geometría básica de un cristal.	
	1.2.2	SUBTEM: La red cristalina	
	1.4.4	OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno analizará	4
	100	comprenderá la idea de red cristalina.	
	1.2.3	SUBTEMA: Planos y direcciones cristalinas	2
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno analizará	
		comprenderá las reglas básicas para determinar los planos y direcciones de una red cristalina.	





	1.2.4	SUBTEMA: Estructuras cristalinas típicas.	2*
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno analizará comprenderá las estructuras cristalinas típicas.	
	1.2.5	SUBTEMA: Cristalografía de Rayos X (Descripción)	4
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno analizará comprenderá la difracción de los rayos X y su utilidad en la determinación de estructuras cristalinas.	
1.3	TEMA: TE	CNOLOGÍA DE SEMICONDUCTORES	16 HRS
	OBJETIVO El alumno Si de cali	o DEL TEMA: o conocerá las diferentes técnicas de obtención de dad electrónica (EGS) y las bases del proceso para ción de semiconductores.	
	1.3.1	SUBTEMA : Técnicas de crecimiento de cristales por los métodos de Czochralski, zona flotante y Bridgman	2
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá tres de las técnicas mas importantes para obtener Si de calidad electrónica.	
	1.3.2	SUBTEMA: Fabricación de uniones PN.	2
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá las técnicas mas importantes para la fabricación de uniones PN.	
	1.3.3	SUBTEMA: Tecnología planar	2
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucra la tecnología planar.	
	1.3.4	SUBTEMA : El proceso de oxidación térmica, pirolítica (C.V.D.) y fotolitografía.	2
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucra la oxidación controlada dentro de la tecnología planar.	
	1.3.5	SUBTEMA : El proceso de difusión por depósito, redistribución y de óxidos impurificados.	2
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucra la difusión controlada dentro de la tecnología planar.	
	1.3.6	SUBTEMA: El proceso crecimiento epitaxial en la	2





	tecnología planar.		
	OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucra el crecimiento epitaxial dentro de la tecnología planar.		
1.3.7	SUBTEMA : El proceso de Implantación iónica en la tecnología planar.		2*
	OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucra la Implantación iónica dentro de la tecnología planar.		
1.3.8	SUBTEMA : Los procesos de metalización, montaje y encapsulado en la tecnología planar.		2*
	OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucran el metalizado, montaje y encapsulado dentro de la tecnología planar.		
		 OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucra el crecimiento epitaxial dentro de la tecnología planar. 1.3.7 SUBTEMA: El proceso de Implantación iónica en la tecnología planar. OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucra la Implantación iónica dentro de la tecnología planar. 1.3.8 SUBTEMA: Los procesos de metalización, montaje y encapsulado en la tecnología planar. OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucran el metalizado, montaje y 	 OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucra el crecimiento epitaxial dentro de la tecnología planar. 1.3.7 SUBTEMA: El proceso de Implantación iónica en la tecnología planar. OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucra la Implantación iónica dentro de la tecnología planar. 1.3.8 SUBTEMA: Los procesos de metalización, montaje y encapsulado en la tecnología planar. OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el proceso que involucran el metalizado, montaje y

MODU	LO 2.		4	IO HRS				
propied	dades de lo	ODULO: El alumno reconocerá analizará y comprenos materiales semiconductores, el diodo de unión Plares (bjt) y los sistemas oxido-silicio.						
2.1	TEMA: PR	TEMA: PROPIEDADES DE LOS SEMICONDUCTORES						
	OBJETIVO DEL TEMA: El alumno reconocerá las diferencias existentes entre el análisis de semiconductores en equilibrio y en conducción, observará las propiedades de los portadores mayoritarios y minoritarios entre los diversos tipos de contactos que se necesitan para el diseño de semiconductores.							
2.1.1 SUBTEMA: Teoría de bandas de energía								
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá la teoría electrónica de bandas.						
	2.1.2 SUBTEMA: Concentración de portadores en equilibrio térmico.							
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá la teoría que involucra la concentración de portadores en equilibrio térmico.						
	2.1.3 SUBTEMA: Conductores, aislantes y semiconductores							
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá la teoría de bandas, las diferencias sustanciales						





li .	de los de conductores, aislantes y semiconductores					
2.1.	4 SUBTEMA: Semiconductores intrínsecos	2				
	OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá las características básicas de los semiconductores intrínsecos.					
2.1.		2				
	OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá las características básicas de los semiconductores extrinsecos.					
2.1.	2.1.6 SUBTEMA: Generación y recombinación OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá las características electrónicas de la generación y recombinación.					
2.1.	2.1.7 SUBTEMA: Contacto metal-metal					
	OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá las características electrónicas del contacto metalmetal.					
2.1.	2.1.8 SUBTEMA: Contacto ohmico OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá las características electrónicas del contacto ohmico					
2.1.	9 SUBTEMA: Contacto rectificante	2				
	OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá las características electrónicas del contacto rectificante					
2.1.1	SUBTEMA: Contacto metal-semiconductor	2*				
	OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá las características electrónicas del contacto metalsemiconductor.					
2.2 TEMA	EL DIODO DE UNION PN	14 HRS				
El alu pn co carac y esta utiliza	OBJETIVO DEL TEMA: El alumno reconocerá la importancia del estudio de la unión pn como elemento básico para lacomprensión de las características de los diversos dispositivos semiconductores y establecerá laterminología y conceptos básicos que son utilizados en la discusión de otros dispositivos semiconductores.					
2.2.	SUBTEMA: Unión abrupta PN	2				





		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá las características electrónicas la unión abrupta PN					
	2.2.2	SUBTEMA: Densidad de portadores en no equilibrio	2				
		CBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá las características teóricas que involucran a la densidad de portadores en no equilibrio. 2.2.3 SUBTEMA: Regiones de Deserción y					
	2.2.3	2					
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá las características teóricas que involucran las regiones de deserción y capacitancia de deserción.					
	2.2.4	SUBTEMA: Características de voltaje-corriente	2				
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el modelo teórico de las características de voltaje-corriente.					
	2.2.5	SUBTEMA: Ruptura de la unión	2*				
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno conocerá el modelo teórico de la ruptura de la unión.					
2.3	TEMA: TR	ANSISTORES BIPOLARES (BJT) Y SISTEMAS	8 HRS				
	inherente MOS,com tecnología	DEL TEMA: El alumno analizará las características s a la construcción de dispositivos BJT y aprenderá la importancia del estudio de esta a que es básica para el desarrollo de circuitos s digitales.					
	2.3.1	SUBTEMA: Introducción al diseño de transistores BJT	4				
		OBJETIVO DEL SUBTEMA: El alumno analizará las características inherentes al diseño de transistores BJT					
	2.3.2	SUBTEMA: Introducción a los sistemas oxidosilicio.	4				

^{*-} Horas no presenciales





CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

CRITERIOS I	DE EVALUACION
EXÁMENES	80
ACTIVIDADES	
NOTA: Se aplicarán 2 exámenes parci	iales

BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA

TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO DE EDICIÓN	% DE COBERTURA DEL CURSO
Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles 3 rd . Ed.	Neamen, Donald A.	Mc Graw Hill,	2003	80%

COMPLEMENTARIA

COMILEMENTARIA				
TITULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO DE EDICIÓN	% DE COBERTURA DEL CURSO
			2003	10%
CMOS Digital Integrated Circuits: Análisis and Design 3 rd . Ed.	Kang, Sung-Mo, Leblebici, Yusuf	Mc Graw Hill,		
Introducción a la Física	Salazar Pérez,	Instituto		60%
Electrónica.	Moisés	Politécnico Nacional,	2001	
Dispositivos Electrónicos Tomo I y II	Cepeda Salinas, Arturo	Instituto Politécnico Nacional,	2001	60%

REVISIÓN REALIZADA POR:

NOMBRE DEL PROFESOR	FIRMA
Dr. Jorge Campa Molina	
Mtro. José Mario Carrión Cortés	





CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Vo.Bo. Presidente de Academia

Dr. Martín Javier Martínez Silva

Vo.Bo. Jefe del Departamento

Mtro. Roberto Cárdenas Rodríguez

martes, 04 de noviembre de 2008